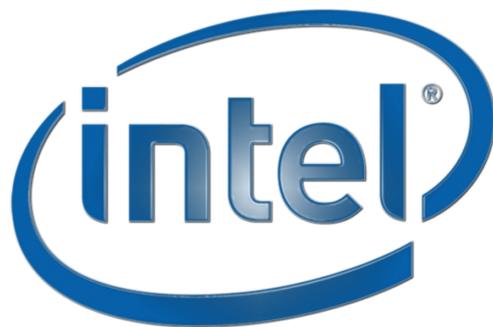




nexthardware.com

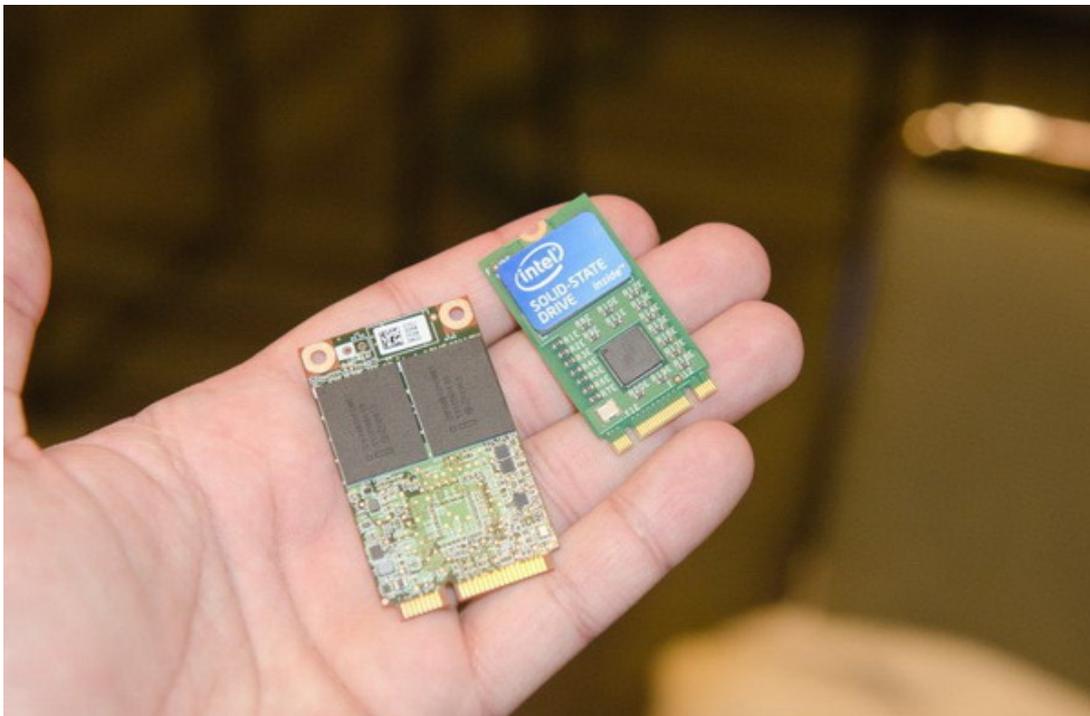
a cura di: Giuseppe Apollo - pippo369 - 04-01-2013 17:00

Intel SSD 530 in arrivo nel secondo trimestre del 2013



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ssd-hard-disk-masterizzatori/5118/intel-ssd-530-in-arrivo-nel-secondo-trimestre-del-2013.htm>)

Il colosso di Santa Clara debutterà a breve con una linea di SSD che utilizzerà il nuovo fattore di forma NGFF.



↔

La nuova linea di ↔ SSD ↔ Intel Serie 530 arriverà nel secondo trimestre del 2013 e sarà composta da drive ↔ nel tradizionale formato da 2,5" e da alcuni modelli che, invece, adotteranno il nuovo fattore di forma NGFF.

Questa nuova serie è stata progettata per offrire elevate prestazioni anche con fattori di forma ridottissimi, fondamentali per l'integrazione all'interno dei moderni Ultra-Thin/Ultrabook.

Il nuovo fattore di forma NGFF, come potete osservare nell'immagine soprastante, ha delle dimensioni talmente contenute da far apparire, al confronto, l'attuale versione mSATA gigantesca.

↔

Trend: NGFF Card Format*

51mm x 30mm
z: 4.85mm

42mm x 22mm
z: 2.75mm single side¹
z: 3.85mm double side¹

mSATA NGFF Card

Proposed Draft Serial ATA International Organization
Version 04 August 14, 2012

Serial ATA Technical Proposal #TPR_C112
Title: NGFF Card Format for SSDs

This is an internal working document of the Serial ATA International Organization. As such, this is not a completed standard and has not been approved. The Serial ATA International Organization may modify the contents at any time. This document is made available for review and comment only.

Specification optimized for caching devices or SSDs, includes a series of module lengths and connector keys enabling SATA*, 2x or 4x PCI Express*

Smaller, thinner, SSD optimized form factor

↔

Un SSD NGFF misura soltanto 42 x 22 mm contro i 51 x 30 mm del formato mSATA ed utilizza una singola interfaccia con pin utilizzabili sia per il protocollo SATA che per quello PCI-Express x2 o x4.

Grazie a questa nuova tecnologia sarà possibile progettare unità ibride che, utilizzando il medesimo PCB, potranno implementare, ad esempio, un SSD SATA su una facciata ed una scheda WLAN 802.11ac sull'altra, con notevole risparmio sia in termini di spazio occupato che di costi.

Questo nuovo fattore di forma permette, inoltre, di implementare su ciascuna facciata del PCB un SSD diverso e di collegarli tra loro in modalità RAID 0.

Gli↔ Intel SSD 530 NGFF saranno introdotti sul mercato nel Q2 2013 in due capacità distinte, pari a 80↔ e 180GB.

↔

COMUNICATO STAMPA